



TB48-M741 (Sn/Bi58)

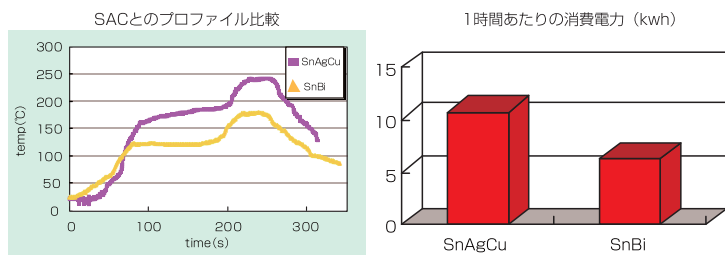
- ▶ Sn/Bi系低融点合金（融点138℃）タイプであり、部品耐熱が厳しい基板実装に対応
- ▶ SACと比較し、リフローによって発生するCO₂の約40%削減が可能
- ▶ 従来Sn/Bi系の課題であった、タックライフ・断続印刷性・Auメッキへの濡れ性の問題を解決

開発コンセプト 地球温暖化対策に貢献！

近年、異常気象が世界各地で多発しており、その原因は地球温暖化であるといわれています。京都議定書では、2012年までに日本の二酸化炭素の排出量を1990年の水準より6%削減することを約束しています。そのうち2.1%を省エネなどで削減、3.9%を日本国内の森林によ

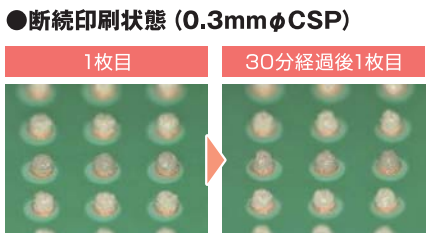
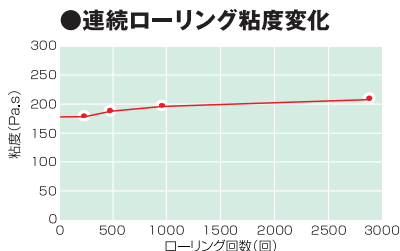
るCO₂の吸収量で達成しようとしています。そこで、当社は低温リフローによる省エネ効果とCO₂排出量削減効果を含めた地球温暖化対策品として低融点ソルダペーストを開発しました。

●低温リフローによるCO₂排出削減効果



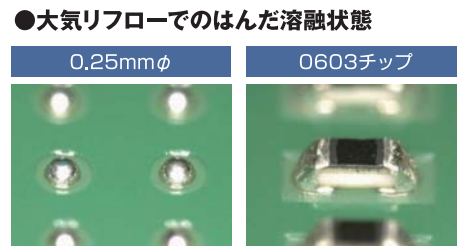
印刷性 優れた粘度安定性！

従来のSnBi系ソルダペーストの特徴として、フラックスとはんだとの反応により、印刷時は増粘の傾向にありました。TB48-M741はフラックス組成の調整により、ローリング時のはんだとフラックスとの反応を大幅に低減し、優れた粘度安定性を実現しました。また、溶剤成分の調整により、タックライフも向上させました。

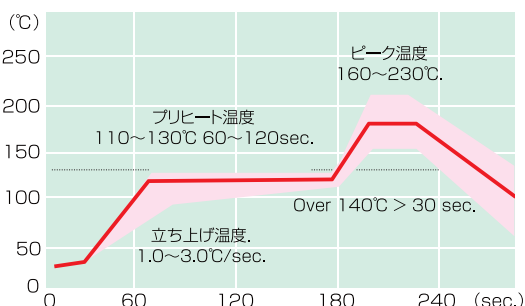


はんだ濡れ性 高い溶融性！

SnBi用にフラックスを開発し、活性組成の最適化を行いました。これにより大気リフローでもファインピッチ実装での確実なはんだ溶融と高いはんだぬれ性を実現させました。



推奨リフロー温度プロファイル



物性表

製品名	TB48-M741
合金組成 (%)	Sn42.0, Bi58.0
融点 (°C)	138
はんだ粒径 (μm)	20 - 45
ハライド含有量 (%) ※フラックス抽出	0.0
フラックス含有量 (%)	11.0
粘度 (Pa.S)	190
銅板腐食試験	合格
タック時間 (h)	> 16
保存ライフ (10℃以下)	3ヶ月